環境に優しい 電子冷却モジュールの開発

-AI用プロセッサなどの冷却に適した小型モジュールー

電子情報部 的場彰成(まとば あきなり)

matoaki@irii.jp

専門: 電子材料、熱電材料、結晶構造解析

一言: 電子機器の冷却に関してお気軽にご相談

下さい。

近年脚光を浴びているAI(人工知能)等に用いられる 高性能プロセッサは発熱が大きく、高温になると性能が 低下します。そこで、プロセッサを冷却するために小型で 効率よく冷却できる電子冷却干ジュールが注目されてい ます。しかし、現在実用化されている電子冷却モジュール では、電気を流すことで冷却させるための熱電材料とし てビスマスとテルルというレアメタルを使用しており、大 量供給が難しいことや毒性があることが課題となってい ます。

この課題を解決するため、レアメタルを使わない電子 冷却モジュールを、戦略的基盤技術高度化支援事業

(H30-R2経済産業省)により㈱白山(金沢市)、北陸先 端科学技術大学院大学と共同で開発しました。図に示す 開発した電子冷却モジュールでは、熱電材料の主原料と して、資源が豊富で毒性のない環境調和材料であるマグ ネシウム、シリコン、スズを用いました。さらに、従来のレ アメタルを用いた場合と同等の性能を引き出すために 電極接合技術を考案し、特許を出願しました。このモジュ ールでは、従来のモジュールと比べて環境に優しいだけ でなく、製造コストを半分以下に抑えることも可能となり ます。

工業試験場では、今後も電子冷却モジュールに関して 研究開発を進め、冷却を必要とする様々な用途で県内企 業への技術支援を行っていきます。

